

证券代码：830976

证券简称：电通微电

主办券商：东北证券

深圳电通纬创微电子股份有限公司

为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

根据深圳电通纬创微电子股份有限公司（以下简称公司或电通微电）经营发展需要，公司的全资子公司电通微电（东莞）半导体有限公司（以下简称东莞半导体）购买了京东都市科技金融创新中心 51 栋工业地产，建筑面积为 11,429 平方米、房款总价约为 9,823.7 万元（以最终竣工决算交付为准）。上述购买资产的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日披露的《购买资产的公告》（公告编号：2023-012）。

公司全资子公司东莞半导体（1）同意向东莞银行股份有限公司东莞分行申请办理余额不超过柒仟柒佰玖拾伍万元整的授信业务，具体事项以本公司与该分行或其辖下分支机构签订的合同约定为准。（2）同意东莞半导体以位于东莞市凤岗镇京东都市科技金融创新中心京科三路 13 号京东都市科技金融创新中心 51 栋 101 号、201 号、301 号、401 号、501 号物业为债务人东莞半导体向东莞银行股份有限公司东莞分行申请办理的授信业务提供抵押担保。具体事项以本公司与该分行或其辖下分支机构签订的合同约定为准。（3）授权法定代表人张建国代表本公司签署与此有关的法律文件、授信材料等相关资料。

电通微电（1）同意为债务人东莞半导体向东莞银行股份有限公司东莞分行申请办理的上述授信业务提供连带责任保证担保。具体事项以本公司与该分行或其辖下分支机构签订的合同约定为准。（2）授权法定代表人或张建国代表本公司

签署与此有关材料。

本次担保金额占公司最近一期经审计归属于挂牌公司股东的净资产的 97.84%，相关担保协议尚未签署，具体条款以与银行签订的担保协议为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 4 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司全资子公司电通微电（东莞）半导体有限公司向东莞银行申请贷款暨公司为该笔贷款提供担保的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本次公司为全资子公司提供担保的金额为 7,795 万元，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的规定，本次担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%（公司 2023 年度经审计的总资产为 214,126,182.70 元，其 30%为 64,237,854.81 元），因此本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：电通微电（东莞）半导体有限公司

成立日期：2024 年 2 月 27 日

住所：广东省东莞市凤岗镇京东路 1 号 19 号楼 350 室

注册地址：广东省东莞市凤岗镇京东路 1 号 19 号楼 350 室

注册资本：50,000,000 元

主营业务：一般项目：集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子产品销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；物业管理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：张建国

控股股东：深圳电通纬创微电子股份有限公司

实际控制人：张建国

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：0 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：0 元

2023 年 12 月 31 日净资产：0 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：0%

2024 年 10 月 31 日资产负债率：0%

2024 年 2-10 月营业收入：0 元

2024 年 2-10 月利润总额：-3,318.10 元

2024 年 2-10 月净利润：-3,318.10 元

审计情况：未审计

其它情况：东莞半导体于 2024 年 2 月成立，目前尚未经营。根据市场调研和公司战略规划，东莞半导体将于京东都市科技金融创新中心 51 栋工业地产正式交付后，开展生产经营活动，届时将获取订单用以还本付息。

三、担保协议的主要内容

东莞半导体（1）同意向东莞银行股份有限公司东莞分行申请办理余额不超过柒仟柒佰玖拾伍万元整的授信业务，具体事项以本公司与该分行或其辖下分支机构签订的合同约定为准。（2）同意东莞半导体以位于东莞市凤岗镇京东都市科技金融创新中心京科三路 13 号京东都市科技金融创新中心 51 栋 101 号、201 号、301 号、401 号、501 号物业为债务人东莞半导体向东莞银行股份有限公司东莞分行申请办理的授信业务提供抵押担保。具体事项以本公司与该分行或其辖下分支机构签订的合同约定为准。（3）授权法定代表人张建国代表本公司签署与此有关的法律文件、授信材料等相关资料。

电通微电（1）同意为债务人东莞半导体向东莞银行股份有限公司东莞分行申请办理的上述授信业务提供连带责任保证担保。具体事项以本公司与该分行或其辖下分支机构签订的合同约定为准。（2）授权法定代表人或张建国代表本公司签署与此有关材料。

相关担保协议尚未签署，具体条款以与银行签订的担保协议为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

上述对外担保，系公司为全资子公司东莞半导体申请的银行授信提供担保，属于对全资子公司的发展给予支持，未向全资子公司收取任何费用，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（二）担保事项的利益与风险

本次对外担保为公司与全资子公司之间的担保行为，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。公司为支持子公司生产经营提供担保，对子公司的业务发展有积极影响。

（三）对公司的影响

公司全资子公司本次向银行申请综合授信额度，并由公司为其综合授信提供担保，均为满足子公司正常经营活动开展的需要，有利于公司长期稳定发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	7,795.00	97.84%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	3,811.36	47.84%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担		

保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

《深圳电通纬创微电子股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》

深圳电通纬创微电子股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日